

证券代码：002916

证券简称：深南电路

### 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-62

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
<b>活动参与人员（排名不分先后）</b>	博时基金、创金合信基金、广发基金、易方达基金、泓德基金、富国基金、汇添富基金、嘉实基金、中欧基金、银华基金、长城基金、国投瑞银基金、长盛基金、东方阿尔法基金、信达澳亚基金、财通基金、方正富邦基金、摩根士丹利基金管理（中国）有限公司、华夏基金、路博迈亚洲有限公司、红杉资本股权投资管理（天津）有限公司、国改双百发展基金、浩成资产、中信建投证券、国信证券、平安证券、山西证券、华创证券、中金公司、中银国际证券、兴业证券、上海申银万国证券、国投证券、民生证券、中泰证券、华泰证券、财通证券、摩根大通证券（中国）有限公司、德邦证券、中信证券、国联证券、广发证券、海通证券、瑞银证券、招商证券、开域资本(新加坡)有限公司、国金证券、浙商证券、中国银河证券、长江证券、中信证券资产管理、方正证券、东方财富证券、上海东方证券资产管理、国信证券、信泰人寿保险、和谐健康保险、西部证券、五矿证券、建信金融资产、建银国际证券、东北证券、浩成资产、广发资管、福建三松集团有限公司、国泰君安国际、华芯投资、中国人保资产、招商信诺资产、百年保险资产、大家资产、普徠仕香港有限公司、国新投资、野村证券、招银国际证券、摩根士丹利、Point72、Hel Ved、Manulife、Pleid Investment Advisors
<b>上市公司接待人员</b>	副总经理、董事会秘书：张丽君；战略发展部总监、证券事务代表：谢丹 证券事务主管：阳佩琴；投资者关系经理：郭家旭
<b>时间</b>	2024年10月29日
<b>地点</b>	网络及电话会议；公司会议室
<b>形式</b>	网络及电话会议；实地调研
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<b>交流主要内容：</b> <b>Q1、请介绍公司2024年三季度经营业绩情况。</b> 2024年前三季度，公司累计实现营业收入130.49亿元，同比增长37.92%，归母净利润累计实现14.88亿元，同比增长63.86%，扣非归母净利润累计实现13.76亿元，同比增长86.67%。单季度层面，2024年第三季度公司实现营业收入47.28亿元，同比增长37.95%，归母净利润实现5.01亿元，同比增长15.33%，扣非归母净利润实现4.72亿元，同比增长

51.53%。

上述变动主要得益于公司把握 2024 年以来行业结构性机会，加大各项业务市场拓展力度，报告期内订单同比增长，三项主营业务收入均实现同比增长，同时由于 AI 的加速演进及应用深化，叠加汽车电动化/智能化趋势延续，以及服务器总体需求回温等因素，推动公司产品结构优化，助益利润同比提升。

**Q2、请介绍公司 2024 年第三季度营业收入及综合毛利率环比变化情况。**

2024 年第三季度，公司营业收入 47.28 亿元，环比增长 8.45%，主要由于电子装联业务项目结算增加影响，营收规模环比增加。公司综合毛利率环比略有下降，一方面由于电子装联业务规模增长（因业务形态特点，其毛利率一般略低于公司综合毛利率）；同时封装基板及 PCB 业务受产品结构变化影响，业务毛利率环比下降。此外，广州封装基板新工厂产能爬坡、原材料涨价对第三季度综合毛利率也造成一定负向影响。

**Q3、请介绍公司 2024 年第三季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。**

公司 PCB 业务产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2024 年第三季度，受通用服务器需求及国内汽车电子产品需求增长影响，公司 PCB 业务营收在数据中心及汽车电子领域环比二季度有所提升，通信领域受无线侧通信基站相关产品需求无明显改善影响，营收占比有所下降。

**Q4、请介绍公司 PCB 业务有无进一步扩产的空间。**

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及未来泰国项目均设有工厂。一方面，公司可通过对现有成熟 PCB 工厂进行持续的技术改造和升级，增进生产效率，释放一定产能；另一方面，公司在南通基地尚有土地储备，具备新厂房建设条件，南通四期项目已有序推进基建工程，拟建设为具备覆盖 HDI 等能力的 PCB 工艺技术平台。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。

**Q5、请介绍公司 2024 年第三季度封装基板业务经营拓展情况。**

公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2024 年第三季

	<p>度,封装基板下游市场需求有所放缓,公司封装基板产品结构随下游市场需求波动有所调整。</p> <p><b>Q6、请介绍公司 2024 年第三季度 PCB 及封装基板工厂稼动率较第二季度变化情况。</b></p> <p>公司 2024 年第三季度 PCB 工厂稼动率环比基本持平,维持在高位水平;封装基板工厂稼动率随下游部分领域需求波动略有回落。</p> <p><b>Q7、请介绍无锡基板二期工厂、广州封装基板项目连线爬坡进展。</b></p> <p>公司无锡基板二期工厂于 2022 年 9 月下旬连线投产,目前已实现单月盈亏平衡。广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线,产品线能力在今年上半年快速提升,目前其产能爬坡尚处于前期阶段,重点仍聚焦平台能力建设,推进客户各阶产品认证工作。</p> <p><b>Q8、请介绍公司封装基板业务在 FC-BGA 技术能力方面取得的进展。</b></p> <p>公司 FC-BGA 封装基板已具备 16 层及以下产品批量生产能力,16 层以上产品具备样品制造能力,其中 20 层产品送样认证工作有序推进中。公司后续将进一步加快高阶领域产品技术能力突破和市场开发,同时也将继续引入该领域的技术专家人才,加强研发团队培养,提升巩固核心竞争力。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定,未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p><b>附件清单</b></p>	<p>无</p>